

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）与预案主要差异情况说明

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司（以下简称“标的公司”）64.69%的股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年12月31日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于<中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》（以下简称“预案”）；2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于<中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“报告书”）。

与本次交易的预案相比，本次交易报告书存在一定差异，现将主要差异情况说明如下：

报告书章节	与预案的主要差异
声明	1、增加本次交易证券服务机构声明； 2、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明、交易对方声明。
释义	为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容
重大事项提示	1、根据上市公司与交易对方签署的各项协议，补充披露本次交易具体方案； 2、根据评估机构出具的《资产评估报告》，对本次交易标的资产评估作价情况进行了补充披露； 3、更新了本次重组对上市公司的影响、本次交易已履行和尚未履行的决策程序及审批程序、本次重组对中小投资者权益保护的安排； 4、新增本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施、其他需要提醒投资者重点关注的事项； 5、删除待补充披露的信息提示。
重大风险提示	1、删除“审计、评估工作尚未完成，交易作价尚未最终确定的风险”、“本次交易后续方案调整的风险”； 2、更新披露了与本次交易相关的风险； 3、更新披露了与标的资产相关的风险。
第一节 本次交易概况	1、更新披露了本次交易方案概述及具体方案；

报告书章节	与预案的主要差异
	2、更新披露了本次交易的性质； 3、更新披露了本次交易对于上市公司的影响； 4、更新披露了本次交易的业绩承诺和补偿安排； 5、更新披露了标的资产评估及作价情况； 6、更新披露了本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序 7、更新本次交易相关方所作出的重要承诺。
第二节 上市公司基本情况	1、补充上市公司历史沿革、股本结构及前十大股东情况； 2、更新最近三年的主营业务发展情况； 3、更新上市公司主要财务指标。
第三节 交易对方基本情况	1、补充交易对方历史沿革及最近三年注册资本变化情况； 2、补充交易对方主营业务发展情况； 3、补充交易对方最近两年主要财务数据； 4、补充交易对方最近一年简要财务报表； 5、补充交易对方主要下属企业情况； 6、补充是否属于私募投资基金及备案情况； 7、补充穿透至最终持有人情况、穿透锁定情况； 8、补充披露了交易对方之间的关系、交易对方与上市公司的关联关系说明、交易对方向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况、交易对方及其主要管理人员最近五年行政处罚、刑事处罚、重大诉讼或仲裁情况、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况。
第四节 交易标的基本情况	1、补充历史沿革； 2、补充近三年内增资、股权转让或改制相关的评估或估值情况分析； 3、补充下属企业情况； 4、补充主要资产权属、对外担保以及主要负债情况； 5、补充诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况； 6、更新披露了标的公司主营业务情况； 7、补充主要经营资质； 8、更新标的公司主要财务数据； 9、补充涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项； 10、补充最近三年申请首次公开发行股票上市的情况及作为上市公司重大资产重组交易标的的情况； 11、补充出资瑕疵或影响其他合法存续的情况； 12、补充许可他人使用资产，或者被许可使用他人资产的情况； 13、补充本次交易不涉及债务转移情况； 14、补充本次交易已取得标的公司其他股东的同意，符合公司章程规定的股权转让前置条件； 15、新增报告期内标的公司主要会计政策及相关会计处理
第五节 标的资产评估作价基本情况	根据披露准则要求，新增本章节

报告书章节	与预案的主要差异
第六节 本次交易发行股份的情况	1、补充披露了交易金额及对价支付方式； 2、补充披露了发行股份数量； 3、补充披露了募集配套资金的金额和用途； 4、补充披露了募集配套资金必要性分析； 5、补充披露了前次募集资金金额、使用情况及目前剩余情况。
第七节 本次交易合同的主要内容	根据披露准则要求，新增本章节
第八节 本次交易的合规性分析	根据披露准则要求，新增本章节
第九节 管理层讨论与分析	根据披露准则要求，新增本章节
第十节 财务会计信息	根据披露准则要求，新增本章节
第十一节 同业竞争和关联交易	根据披露准则要求，新增本章节
第十二节 风险因素	1、删除“审计、评估工作尚未完成，交易作价尚未最终确定的风险”、“本次交易后续方案调整的风险”； 2、更新披露了与本次交易相关的风险； 3、更新披露了与标的资产相关的风险。
第十三节 其他重要事项	1、补充披露了标的公司和上市公司资金占用及担保情况； 2、补充披露了本次交易对于上市公司负债结构的影响； 3、补充披露了本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明； 4、补充披露了内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况； 5、删除本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
第十四节 对本次交易的结论性意见	1、补充独立董事意见； 2、补充独立财务顾问意见； 3、补充法律顾问意见。
第十五节 本次交易有关中介机构情况	根据披露准则要求，新增本章节
第十六节 董事、高级管理人员及有关中介机构声明	1、更新上市公司及其董事、高级管理人员声明； 2、补充相关中介机构的声明。
第十七节 备查文件及备查地点	根据披露准则要求，新增本章节

注：上述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案主要差异情况说明》之盖章页）

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026年3月30日